证券代码:601111 证券简称:中国国航 公告编号:2024-001

中国国际航空股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2024年1月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2024年1月26日 11点30分
召开地点:中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年1月26日
至2024年1月26日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
未公开征集股东投票权。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	H股股东
非累积投票议案			
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	√	√
2.00	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案	√	√
2.01	发行股票的种类和面值	√	√
2.02	发行方式及发行时间	√	√
2.03	发行对象和认购方式	√	√
2.04	发行价格与定价方式	√	√
2.05	发行数量	√	√
2.06	限售期安排	√	√
2.07	上市地点	√	√
2.08	本次发行前的滚存未分配利润安排	√	√
2.09	募集资金数额及用途	√	√
2.10	本次发行决议有效期限	√	√
3	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案	√	√
4	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	√	√
5	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案	√	√
6	关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体就措施作出承诺的议案	√	√
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√	√
8	关于公司与特定对象签订附条件生效的A股股票认购协议暨关联(连)交易的议案	√	√
9.00	关于公司2023年度向特定对象发行H股股票方案的议案	√	√
9.01	发行股票的种类和面值	√	√
9.02	发行方式及发行时间	√	√
9.03	发行对象和认购方式	√	√
9.04	发行价格与定价方式	√	√
9.05	发行数量	√	√
9.06	限售期安排	√	√
9.07	募集资金数额及用途	√	√
10	关于公司与特定对象签订附条件生效的H股股票认购协议暨关联(连)交易的议案	√	√
11	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行股票工作相关事宜的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过,详见公司于2023年12月23日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《中国国际航空股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告》。
2、特别决议议案:第2-5项、第8-11项议案
3、对中小投资者单独计票的议案:第2-6项、第8-11项议案
4、涉及关联股东回避表决的议案:第2-5项、第8-11项议案
应回避表决的关联股东名称:中国航空集团有限公司、中国航空(集团)有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席2024年第一次临时股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 H股股东参会事项,参见公司发布的H股股东大会通知。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601111	中国国航	2024/1/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一) 登记方式:出席股东可在本通知载明的时间及地点现场办理出席登记手续,也可通过信函办理。
(二) 登记时间:2024年1月25日(星期二)9:00时-17:00时;通过信函办理登记的,信函到达邮戳日应不迟于2023年1月25日。
(三) 登记地点:中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼董事会办公室。
(四) 登记要求:符合出席条件的股东如欲出席现场会议,须提供以下登记资料:
自然人股东:本人身份证原件及复印件、股东账户卡或其他股东身份证明文件;委托代理人出席会议的,须提交书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。
法人股东:法定代表人出席会议的,须提交加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证;法人股东的法定代表人委托代理人出席股东大会的,代理人应当出示本人身份证明及由法定代表人签署的委托书;法人股东董事会、其他决策机构决议授权的人出席股东大会的,该代理人应当出示本人身份证明和法人股东的董事会或者其他权力机构的决议授权书,并应加盖法人印章。
(五) 联系地址:中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号,邮编101312。
(六) 联系人:秦志杰、陆远
联系电话:86-10-61462558、86-10-61462790
六、其他事项
与会股东及其代理人的住宿及交通费用自理。
特此公告。

中国国际航空股份有限公司董事会
2024年1月9日

附件1:授权委托书
报备文件:提议召开2024年第一次临时股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
(2024年第一次临时股东大会)
中国国际航空股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月26日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案			
2.00	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式及发行时间			
2.03	发行对象和认购方式			
2.04	发行价格与定价方式			
2.05	发行数量			
2.06	限售期安排			
2.07	上市地点			
2.08	本次发行前的滚存未分配利润安排			
2.09	募集资金数额及用途			
2.10	本次发行决议有效期限			
3	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案			
4	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案			
5	关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性研究报告的议案			
6	关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体就措施作出承诺的议案			
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案			
8	关于公司与特定对象签订附条件生效的A股股票认购协议暨关联(连)交易的议案			
9.00	关于公司2023年度向特定对象发行H股股票方案的议案			
9.01	发行股票的种类和面值			
9.02	发行方式及发行时间			
9.03	发行对象和认购方式			
9.04	发行价格与定价方式			
9.05	发行数量			
9.06	限售期安排			
9.07	募集资金数额及用途			
10	关于公司与特定对象签订附条件生效的H股股票认购协议暨关联(连)交易的议案			
11	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行股票工作相关事宜的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:688469 证券简称:芯联集成 公告编号:2024-004

芯联集成电路制造股份有限公司 关于公司控股子公司 向银行申请项目贷款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
芯联集成电路制造股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司芯联先锋集成电路制造(绍兴)有限公司(以下简称"芯联先锋")拟向银行申请不超过人民币70亿元的项目贷款。
该事项无需提交公司股东大会审议
一、公司控股子公司申请项目贷款情况概述
根据芯联先锋与绍兴滨海新区管委会签订《落户协议》的相关内容,计划三期12英寸中试项目的基础上,实施量产项目,预计在未来两到三年内合计形成投资222亿元人民币、10万片/月产能规模的中芯绍兴三期12英寸数模混合集成电路芯片制造项目。具体内容详见《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于公司子公司与绍兴滨海新区管委会签订<落户协议>的公告》(公告编号:2023-005)。
公司于2023年5月31日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过《关于新增募投项目、调整募投项目投资金额并使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的议案》,同意公司新增募投项目"中芯绍兴三期12英寸特色工艺晶圆制造中试线项目"。具体内容详见公司于2023年6月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于新增募投项目、调整募投项目投资金额并使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的公告》(公告编号:2023-007)。
公司于2024年1月9日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过《关于新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的议案》,拟实施"三期12英寸集成电路数模混合芯片制造项目"(以下简称"本项目")。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的公告》(公告编号:2024-001)
为保证本项目的顺利实施,根据目前项目的建设计划,芯联先锋拟将以本项目不超过价值人民币70亿元的设备作为抵押物向银行申请总额不超过人民币70亿元的项目贷款。具体贷款金额、期限、利率等以最终与银行签订的协议为准。芯联先锋将授权其总经理签署借款合同及其他相关文件。
二、审议程序
公司于2024年1月9日召开第一届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司控股子公司向银行申请项目贷款的议案》,同意公司控股子公司将以本项目不超过价值人民币70亿元的设备作为抵押物向银行申请不超过人民币70亿的项目贷款的事项。
特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会
2024年1月10日

证券代码:688469 证券简称:芯联集成 公告编号:2024-002

芯联集成电路制造股份有限公司 关于对外投资暨向控股子公司增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
投资标的名称:芯联先锋集成电路制造(绍兴)有限公司(以下简称"芯联先锋")
投资金额:28.875亿(其中27.90亿元为公司募集资金,0.975亿元为公司自有资金)
特别风险提示:
1.本次投资金额中以公司募集资金投入的27.90亿元尚需经过股东大会审议。
2.本项目是公司基于对自身条件和市场前景的判断,后续如行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化,可能导致该项目的经营状况及盈利能力不达预期。
3. 如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化,项目的实施可能存在顺延、变更的风险。
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
根据公司子公司芯联先锋与绍兴滨海新区管委会签订《落户协议》的相关内容,计划在三期12英寸中试项目的基础上,实施量产项目,预计在未来两到三年内合计形成投资222亿元人民币、10万片/月产能规模的中芯绍兴三期12英寸数模混合集成电路芯片制造项目。具体内容详见《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于公司子公司与绍兴滨海新区管委会签订<落户协议>的公告》(公告编号:2023-005)。
公司于2023年5月31日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过《关于新增募投项目、调整募投项目投资金额并使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的议案》,同意将募集资金22.10亿元通过向芯联先锋增资的方式用于募投项目"中芯绍兴三期12英寸特色工艺晶圆制造中试线项目"。具体内容详见公司于2023年6月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于新增募投项目、调整募投项目投资金额并使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的公告》(公告编号:2023-007)。
公司于2024年1月9日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过《关于新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的议案》,拟将募集资金27.90亿元通过向芯联先锋增资的方式用于新增募投项目"三期12英寸集成电路数模混合芯片制造项目",该事项尚需经股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的公告》(公告编号:2024-001)。
为保障"三期12英寸集成电路数模混合芯片制造项目"的顺利实施,公司与绍兴富浙越芯集成电路产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称"富浙越芯")拟对芯联先锋进行第一阶段增资38.50亿元,其中公司增资28.875亿元,占本次增资总额的75%。公司本次增资的28.875亿元中27.90亿元来源于公司募集资金,0.975亿元为公司自有资金。
(二)对外投资的决策与审批程序
公司于2024年1月9日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资暨向控股子公司增资的议案》,本事项无需提交股东大会审议。
本次公司增资中来源于募集资金的27.90亿元已经第一届董事会第十九次会议审议通过,尚需经过股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的公告》(公告编号:2024-001)。
(三)不属于关联交易和重大资产重组事项说明
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定,本次投资事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组情形。
二、交易对方的基本情况
(一)绍兴富浙越芯集成电路产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)
1、企业性质:有限合伙企业
2、注册地及主要办公地点:浙江省绍兴市越城区皋埠街道银桥路326号1幢4楼438室
3、执行事务合伙人:浙江富浙股权投资基金管理有限公司
4、执行事务合伙人委派代表:沈梦怡
5、主要股东:绍兴滨海新区集成电路产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、浙江富浙资本管理有限公司、浙江富浙股权投资基金管理有限公司
6、注册资本:26亿元
7、经营范围:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动
8、最近一年主要财务指标:因富浙越芯为2023年新设企业,故无最近一年主要财务指标。执行事务合伙人浙江富浙股权投资基金管理有限公司2022年底总资产5,069.28万元、净资产4,257.26万元,2022年度营业收入3,928.47万元、净利润1,079.71万元。
9、关联关系说明:富浙越芯与公司不存在关联关系
三、投资标的基本情况
(一)投资标的的基本情况
1、公司名称:芯联先锋集成电路制造(绍兴)有限公司
2、经营范围:集成电路制造;集成电路芯片及产品制造;集成电路设计;集成电路芯片设计及服务;集成电路销售;集成电路芯片及产品销售;电力电子元器件销售;电力电子元器件制造;电子元器件制造;货物进出口;技术进出口;租赁服务(不含许可类租赁服务);机械设备租赁;非居住房地产租赁;住房租赁;(限自有房屋租赁)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
3、注册资本:30亿元
4、增资方式:根据2024年1月9日公司第一届董事会第十九次会议决议,公司将以人民币28.875亿元认购新增注册资本28.875亿元。富浙越芯以人民币9.625亿元认购新增注册资本9.625亿元。
5、增资前后的股权结构:
本次增资前芯联先锋股权结构如下:

股东名称	认缴注册资本(万元)	持股比例
芯联集成	225,000.00	75%
芯瑞基金	75,000.00	25%
合计	300,000.00	100%

本次增资后芯联先锋股权结构如下:

股东名称	认缴注册资本(万元)	实缴注册资本(万元)	持股比例
芯联集成	513,750.00	513,750.00	75.00%
富浙越芯	96,250.00	96,250.00	14.05%
芯瑞基金	75,000.00	75,000.00	10.95%
合计	685,000.00	685,000.00	100.0000%

6、最近一年又一期的主要财务指标:
单位:万元

项目	2022.12.31/2022年度	2023年9月30日/2023年1-9月
总资产	199,806.23	889,254.20
净资产	170.90	242,699.70
营业收入	1,660.00	3,719.92
净利润	-3,858.80	-53,693.15
审计情况	经天职国际审计	未经审计

(二)项目主要情况
1、项目名称:三期12英寸集成电路数模混合芯片制造项目
2、项目内容:项目总投资180亿元,用于建设月产9万片的硅基12英寸晶圆加工生产线。
3、本轮增资涉及各投资方的出资义务:公司以人民币28.875亿元认购新增注册资本28.875亿元,累计总投资51.375亿元,占增资后注册资本的75%。富浙越芯以人民币9.625亿元认购新增注册资本9.625亿元,占增资后注册资本的14.05%。
4、项目建设期:整体项目计划于2025年开始投产。
四、投资协议的主要内容
(一)投资款的缴付
在交割先决条件均得到满足或被本轮投资方豁免的前提下,芯联集成在1月31日或富浙越芯完成中国证券投资基金业协会备案之日起一(1)个工作日内(以孰晚为准)完成出资;富浙越芯在芯联集成完成芯联集成增资款支付的前提下,于2024年1月31日前或富浙越芯完成中国证券投资基金业协会备案之日起三(3)个工作日内(以孰晚为准)完成出资。
(二)共同出售权约定
如果芯联集成拟向任何一方直接或间接出售或以其他方式处置其持有的全部或部分公司股权应当提前十个工作日书面通知芯瑞基金及富浙越芯,芯瑞基金及富浙越芯有权(但没有义务)根据本条的约定按照受让方提出的相同的价格和条款条件,向受让方转让其持有的公司股权("共同出售权")。
(三)违约责任
1、一方若未能按照本协议的约定按期、足额缴纳出资的,每延期一日,应按照应缴未缴金额的万分之五的标准向公司支付滞纳金。
2、除本协议其他条款另有约定外,由于本协议任何一方违反本协议规定的义务,造成本协议不能履行或不能完全履行时,由违约方承担违约责任,赔偿因其违约行为而给守约方造成的全部实际损失。如存在两方以上的合同方有违约行为,则由违约各方按照其各自的违约程度分别承担违约责任。
3、本协议项下各方均分别承担违约责任,不存在任何性质的连带违约责任。
4、各本轮投资方在本协议项下的权利和义务为分别且不连带的,任何本轮投资方均不对其他本轮投资方的行为承担任何责任,且任何本轮投资方对其权利的行使或豁免均不影响其他本轮投资方行使或豁免其任何权利。
(四)争议解决方式
1、本协议的订立、效力、解释、履行和争议的解决均应受中国法律的管辖,并依其解释。
2、凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议,各方应通过友好协商解决。如果争议在首次协商后六十(60)日内不能以各方可接受的方式解决,则任何一方有权将该等争议、纠纷或索赔提交公司所在地有管辖权的人民法院通过诉讼的方式解决。
3、争议解决期间,各方继续拥有各自在本协议项下的其它权利并应继续履行其在本协议下的相应义务。
(五)协议的生效、补充、修改、变更和解除
1、本协议经协议各方签署完成,并由芯联集成按中国法律、科创板上市规则及芯联集成公司章程规定、芯瑞基金按中国法律及芯瑞基金合伙协议等规定、芯联先锋按中国法律及《公司章程》规定,完成相应决策程序后生效。
2、经本协议各方协商一致,可以对本协议进行修改或变更。任何修改或变更必须制成书面文件,经本协议各方签署后生效。
上述投资协议暂未签订,具体内容以各方签署的最终协议约定为准。
五、对外投资对上市公司的影响
本次投资协议的签订,有利于公司的长远发展,符合公司整体战略规划。有助于公司扩大市场占有率,提升市场竞争力。
公司本次对外投资的资金来源为公司募集资金以及自有资金,公司目前财务状况良好,预计不会对公司的正常生产及经营产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
六、对外投资的风险分析
(一)本次投资金额中以公司募集资金投入的27.90亿元尚需经过股东大会审议。
(二)本项目是公司基于对自身条件和市场前景的判断,后续如行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化,可能导致该项目的经营状况及盈利能力不达预期。
(三)如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件及融资环境发生变化,项目的实施可能存在顺延、变更的风险。
(四)公司将根据项目进展情况,严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会
2024年1月10日

证券代码:688469 证券简称:芯联集成 公告编号:2024-005

芯联集成电路制造股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
芯联集成电路制造股份有限公司第一届监事会第十一次会议于2024年1月9日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年1月2日向全体监事发出。会议应出席监事5人,实际出席监事5人,会议由监事会主席王永先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的议案》
监事会认为:公司本次新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资,结合了公司的实际经营情况及未来发展重点,有利于公司的长远发展及规划,可以有效整合公司内部资源,提高运营及管理效率和募集资金的使用效率,有利于保障募投项目的顺利实施,且履行了相应的审批程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次调整不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金用途,或损害股东利益,特别是中小股东利益的情形。
综上,监事会同意公司新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的事项。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的公告》(公告编号:2024-001)
2、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
监事会认为:公司本次募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金,是基于募投项目实施的实际情况,符合公司发展规划,能够充分发挥募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。上述事项履行了必要的审议程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司相关募集资金管理制度的规定。
综上,监事会同意公司本次募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金事项。
表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《芯联集成电路制造股份有限公司关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-003)
特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司监事会
2024年1月10日

证券代码:688469 证券简称:芯联集成 公告编号:2024-001

芯联集成电路制造股份有限公司 关于新增募投项目、调整部分募集资金 向新增募投项目的实施主体增资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
原项目名称:二期晶圆制造项目
新项目名称:三期12英寸集成电路数模混合芯片制造项目
投资总金额:人民币180亿元
合作对方:绍兴滨海新区芯瑞创业投资基金合伙企业(有限合伙)、绍兴富浙越芯集成电路产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)
变更募集资金投向的金额:27.9亿元
新项目预计正常投产并产生收益的时间:新项目预计2025年开始投产。
一、变更募集资金投资项目的概述
(一)募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年3月13日出具的《关于同意绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕548号),并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股169,200.00万股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股人民币5.69元,募集资金总额为人民币962,748.00万元(行使超额配售选择权之前),扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为人民币937,276.55万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年5月5日出具了《验资报告》(天职业字[2023]33264号),验证募集资金已全部到位。
2023年6月8日,保荐人海通证券股份有限公司(主承销商)全额行使超额配售选择权,公司在初始发行169,200.00万股普通股的基础上额外发行25,380.00万股普通股,由此增加的募集资金总额为144,412.20万元,扣除发行费用(不含增值税)3,347.05万元,超额配售募集资金净额为141,065.15万元。保荐机构(主承销商)已于2023年6月9日将全额行使超额配售选择权所对应的募集资金扣除承销费用(不含增值税)后划付给公司。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验,并于2023年6月9日出具了《验资报告》(天职业字[2023]35399号)。
全额行使超额配售选择权后,公司在初始发行169,200.00万股普通股的基础上额外发行25,380.00万股普通股,故本次发行最终募集资金总额为1,107,160.20万元。扣除发行费用28,818.50万元,募集资金净额为1,078,341.70万元。
为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议。具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》以及《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》(公告编号:2023-019)。
根据《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资计划,公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六次会议根据实际募集资金净额对公司募投项目使用募集资金投资金额进行的调整,以及公司第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第七次会议基于新增募投项目,对公司募投项目使用募集资金投资金额进行的调整,调整后的募集资金使用计划如下:
单位:亿元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金总额
1	MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地技术改造项目	65.64	–
2	二期晶圆制造项目	110.00	44.50
3	中芯绍兴三期12英寸特色工艺晶圆制造中试线项目	42.00	22.10
4	补充流动资金	43.40	41.23
合计		261.04	107.83

(二)募投项目变更情况
公司于2023年5月31日召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过《关于新增募投项目、调整募投项目投资金额并使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的议案》,同意调减拟使用募集资金投资的金额22.10亿元,并将该等调减金额通过向公司子公司芯联先锋集成电路制造(绍兴)有限公司(以下简称"芯联先锋")增资的方式用于新增募投项目"中芯绍兴三期12英寸特色工艺晶圆制造中试线项目"。具体内容详见公司于2023年6月1日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于新增募投项目、调整募投项目投资金额并使用部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的公告》(公告编号:2023-007)
公司于2024年1月9日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过《关于新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的议案》,独立董事发表了同意的独立意见,本事项尚需股东大会审议,本事项不构成关联交易。
截止目前,公司已投入"二期晶圆制造项目"的募集资金金额为16.60亿元,已投入"中芯绍兴三期12英寸特色工艺晶圆制造中试线项目"的募集资金金额为22.10亿元。
因原募集资金投资项目"二期晶圆制造项目"的资金缺口部分已于前期由公司通过向银行申请50亿元项目贷款的形式完成投资(与公司两次调整募集资金金额之和相同),现已达到预定可使用状态,本次会议同意调减"二期晶圆制造项目"拟使用募集资金投资的金额27.90亿元,并将该等调减金额通过向公司控股子公司芯联先锋增资的方式用于新增募投项目"三期12英寸集成电路数模混合芯片制造项目"。具体调整情况如下:
单位:亿元

调整前后对比	项目名称	实施主体	实施地点	调整后拟使用募集资金总额
本次募集资金投向调整前	二期晶圆制造项目	芯联越州	浙江绍兴	44.50
本次募集资金投向调整后	二期晶圆制造项目	芯联越州	浙江绍兴	16.60
	三期12英寸集成电路数模混合芯片制造项目	芯联先锋	浙江绍兴	27.90

本次新增募投项目后的募集资金使用情况如下:
单位:亿元

序号	项目名称	项目总投资	拟使用募集资金总额
1	MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地技术改造项目	65.64	–
2	二期晶圆制造项目	110.00	16.60
3	中芯绍兴三期12英寸特色工艺晶圆制造中试线项目	42.00	22.10
4	三期12英寸集成电路数模混合芯片制造项目	180.00	27.90
5	补充流动资金	43.40	41.23
合计		441.04	107.83

二、本次新增募投项目及调整募投项目使用募集资金投资的金额的原因
(一)新增募投项目的原因
公司是国内领先的特色工艺晶圆代工企业,主要从事功率半导体和MEMS传感器等模拟类芯片领域的一站式晶圆代工及封装测试业务。在公司聚焦的功率应用方向上,公司不仅拥有种类完整、技术先进的功率器件布局,同时也在不断完善功率IC和功率模组的全面布局,以满足各类客户不断延伸的需求。
为了进一步提升功率模组应用配套所需各类芯片的大规模生产制造能力,降低生产运营成本,提升产品综合竞争力,公司子公司与绍兴滨海新区管委会签订《落户协议》,拟建设"三期12英寸集成电路数模混合芯片制造项目",致力于实现国内12英寸车载功率半导体芯片的工艺自主化和大规模制造产业化。因本项目规划的产品市场需求量大,并通过前期三期12英寸中试线项目充分地完成技术验证,因此急需抓住时代机遇,利用三期项目实现规模化量产。故拟使用部分募集资金投入到该项目来满足12英寸硅基芯片的生产需求。
(二)原募投项目基本情况以及本次调减募集资金投资金额的原因
2023年5月15日,公司召开第一届董事会第十三次会议及监事会第六次会议审议同意投入到"二期晶圆制造项目"的募集资金金额为66.60亿元。2023年6月16日,公司召开2023年度第一次临时股东大会审议同意将投入到"二期晶圆制造项目"的募集资金金额调减为44.50亿元。截至目前,实际投入"二期晶圆制造项目"的募集资金金额为16.60亿元,其余资金缺口部分已由公司通过银行项目贷款的形式完成,现剩余募集资金27.90亿元及其利息。
为提高募集资金使用效率,且考虑到目前公司"三期12英寸集成电路数模混合芯片制造项目"对资金需求迫切,故拟将原计划用于"二期晶圆制造项目"的剩余募集资金27.90亿元调整至"三期12英寸集成电路数模混合芯片制造项目"。
三、新增募投项目情况说明
1、项目名称:三期12英寸集成电路数模混合芯片制造项目
2、实施主体:芯联先锋
3、投资总额:180亿元
4、建设内容:建成月产9万片的硅基12英寸晶圆加工生产线,主要包括HVIC(BCD)等功率驱动芯片,IGBT、SJ等功率芯片。
5、主要经济指标:

序号	项目名称	单位	指标数据	备注
1	总投资	亿元	180.00	
2	营业收入	亿元	89.07	达产年平均
3	增值税及附加	亿元	6.62	达产年平均
4	利润总额	亿元	21.82	达产年平均
5	毛利率	%	32.54	达产年平均
6	投资回收期	年	8.22	所得税后

注:以上数据表明项目有一定的经济效益,在经济上可行。
四、新增募投项目的市场前景和风险提示
(一)市场前景
近年来,全球的功率半导体产业取得了飞速发展,国内的功率半导体正在逐渐缩小与国外产品的差距。现阶段,面对未来庞大的市场需求,国内的模拟芯片在关键技术领域有所欠缺,自给率较低,贸易逆差较大。为响应国家号召,打破现有的不平衡格局,公司依托自主研发的技术专利和量产积累,搭建12英寸车规级功率半导体芯片的国产化平台。
(二)风险提示
1、技术风险及对策
半导体晶圆代工行业属于技术密集型行业,半导体晶圆代工涉及数十种科学技术及工程领域学科知识的综合应用,具有工艺技术迭代快、资金投入大、研发周期长等特点,可能导致工艺技术定位偏差。同时,新工艺的研发过程较为复杂,耗时较长且成本较高,存在不确定性。且技术壁垒是保持竞争力的重要环节,产品研发、生产、销售活动所涉及的知识产权风险未归属明确,可能造成知识产权侵权风险。新产品、新技术泄密将削弱竞争力,带来经济损失。
针对上述风险,公司在布局新增募投项目将立足于已有的技术,并通过自主技术创新和抓住承担国家科技中长期重大专项成套工艺开发项目实施机会,逐步夯实项目的工艺技术研发基础。同时,公司将通过国际合作,提高研发的有效性,确保良好地吸收引进的技术。此外,公司将制定一系列严格完善的保密制度,确保核心技术的保密性。
2、市场风险及对策
受到全球宏观经济的波动、行业景气度以及国际地缘政治对半导体产业的影响,半导体市场呈现出周期性波动的特征,市场竞争激烈;产品能否获得可靠、稳定的市场订单也是项目运营的关键因素之一。上述因素都将对项目的持续发展造成不确定性。
针对上述风险,公司将利用现有市场经营网络,与客户共同投资、深度合作,补充产品验证期间的产量不足问题,绑定主要客户的同时积极开发新用户,利用并扩大现有的市场,拓展产品的应用领域,为设计公司提供市场需求的产品。
3、管理、运营风险及对策
本项目的实施将使芯联先锋规模扩大,人员数量增加,虽然建立了较为完整的公司治理机制,制定了公司章程及其他内部管理制度,但由于新加入的人员将会较多,管理团队仍需相互磨合。因此,公司治理机制的融合可能影响公司运营。
针对上述风险,公司组织了先期项目团队。通过前期项目的顺利执行,充分考验了公司管理和运营机制,锻炼了管理和运营团队。
4、供应链风险及对策
集成电路晶圆代工行业对原材料、零备件和设备等有较高要求,部分重要原材料、备品备件及核心设备等在全球范围内的合格供应商数量较少,且大多来自中国境外。未来,如果公司的重要原材料、备品备件或者核心设备等发生供应短缺、延迟交货、价格大幅上涨,或者供应商所处的国家和/或地区与他国发生贸易摩擦、外交冲突、战争等进而影响到相应原材料、备品备件及设备等制品的出口许可、供应或价格上涨,将可能会对公司生产经营及持续发展产生不利影响。
针对上述风险,本项目涉及的模拟和数模混合类设备没有受到限制,同时公司也会加大国产设备、原材料、备品备件供应商的评估范围和力度,保障供应链安全。
5、持续资金投入的风险及对策
半导体晶圆代工行业属于资本密集型行业。公司需要持续进行巨额的资金投入来持续追赶世界先进工艺,保持市场竞争优势,保证充足的产能,提高核心竞争力。
针对上述风险,前期项目已产生良好的现金流,保障了持续投资的可行性;公司经营情况良好,获得银行充足的授信额度;公司将持续发挥自身优势,以更快的速度响应国内外客户需求,保障产品交付。
五、公司履行的审议程序
本次新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的事项已经第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过,公司独立董事对此发表了明确同意的意见,保荐机构出具了核查意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。
六、专项意见说明
(一)独立董事意见
独立董事认为:考虑到公司未来业务发展和产能的区域布局规划,为充分发挥募集资金作用、加快推进募投项目建设进度,公司新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资,可以有效整合公司内部资源,提高运营及管理效率和募集资金的使用效率,有利于保障募投项目的顺利实施,且履行了相应的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定,符合公司实际情况和未来经营发展需要,不存在损害公司股东,特别是中小股东的利益的情形。
综上,独立董事同意公司新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资事项。
(二)监事会意见
监事会认为:公司本次新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资,结合了公司的实际经营情况及未来发展重点,有利于公司的长远发展及规划,可以有效整合公司内部资源,提高运营及管理效率和募集资金的使用效率,有利于保障募投项目的顺利实施,且履行了相应的审批程序,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次调整不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金用途,或损害股东利益,特别是中小股东利益的情形。
综上,监事会同意公司新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的事项。
(三)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司本次新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资事项已经董事会、监事会审议通过,公司独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的内部审批程序,尚需提交股东大会审议,符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定,不存在损害公司股东,特别是中小股东的利益的情形。
综上,保荐机构对公司本次新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的事项无异议。
七、上网公告附件
1、《芯联集成电路制造股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关审议事项的独立意见》
2、《海通证券股份有限公司关于芯联集成电路制造股份有限公司新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的核查意见》
特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会
2024年1月10日

证券代码:688469 证券简称:芯联集成 公告编号:2024-003

芯联集成电路制造股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
截至2023年12月31日,芯联集成电路制造股份有限公司(以下简称"公司")募投项目"MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地技术改造项目"、"二期晶圆制造项目"以及"中芯绍兴三期12英寸特色工艺晶圆制造中试线项目"已完成建设并达到预定可使用状态。目前,公司8英寸硅基晶圆生产线月产能已达到17万片,同时已建成一条集研发和月产1万片12英寸集成电路特色工艺晶圆小规模工程化、国产验证及生产验证的中试实验线。
公司于2024年1月9日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将首次公开发行募投项目"MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地技术改造项目"、"二期晶圆制造项目"以及"中芯绍兴三期12英寸特色工艺晶圆制造中试线项目"结项,节余募集资金用于永久补充公司流动资金。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构对本次事项出具了明确同意的核查意见。本事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2023年3月13日出具的《关于同意绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕548号),并经上海证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股169,200.00万股,每股面值为人民币1元,发行价格为每股人民币5.69元,募集资金总额为人民币962,748.00万元(行使超额配售选择权之前),扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为人民币937,276.55万元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年5月5日出具了《验资报告》(天职业字[2023]33264号),验证募集资金已全部到位。
2023年6月8日,保荐人海通证券股份有限公司(主承销商)全额行使超额配售选择权,公司在初始发行169,200.00万股普通股的基础上额外发行25,380.00万股普通股,由此增加的募集资金总额为144,412.20万元,扣除发行费用(不含增值税)3,347.05万元,超额配售募集资金净额为141,065.15万元。保荐机构(主承销商)已于2023年6月9日将全额行使超额配售选择权所对应的募集资金扣除承销费用(不含增值税)后划付给公司。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验,并于2023年6月9日出具了《验资报告》(天职业字[2023]35399号)。
全额行使超额配售选择权后,公司在初始发行169,200.00万股普通股的基础上额外发行25,380.00万股普通股,故本次发行最终募集资金总额为1,107,160.20万元。扣除发行费用28,818.50万元,募集资金净额为1,078,341.70万元。
为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方/四方监管协议。具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》以及《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》(公告编号:2023-019)。
二、募投项目基本情况
根据《绍兴中芯集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资计划,公司第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六次会议根据实际募集资金净额对公司募投项目使用募集资金投资金额进行的调整以及公司第一届董事会第十四次会议、第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第七次会议、第一届监事会第十一次会议基于新增募投项目对公司募投项目使用募集资金投资金额进行的调整,调整后的募集资金使用计划如下:
单位:亿元

序号	项目名称	项目总投资	调整后拟使用募集资金总额
1	MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地技术改造项目	65.64	–
2	二期晶圆制造项目	110.00	16.60
3	中芯绍兴三期12英寸特色工艺晶圆制造中试线项目	42.00	22.10
4	三期12英寸集成电路数模混合芯片制造项目	180.00	27.90
5	补充流动资金	43.40	41.23
合计		441.04	107.83

三、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
(一)募投项目结项及节余募集资金情况
公司本次结项的募投项目为"MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地技术改造项目"、"二期晶圆制造项目"以及"中芯绍兴三期12英寸特色工艺晶圆制造中试线项目",截至2023年12月31日,"MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地技术改造项目"、"二期晶圆制造项目"以及"中芯绍兴三期12英寸特色工艺晶圆制造中试线项目"已完成建设并达到预定可使用状态。目前,公司8英寸硅基晶圆生产线月产能已达到17万片,同时已建成一条集研发和月产1万片12英寸集成电路特色工艺晶圆小规模工程化、国产验证及生产验证的中试实验线。本次结项募投项目募集资金具体使用及节余情况如下:
单位:万元

序号	项目名称	募集资金拟投入总额	截至2023年12月31日累计投入金额	利息及理财收益净额	募集资金专户余额
1	MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地技术改造项目	–	–	–	–
2	二期晶圆制造项目	166,000.00	166,000.00	4,967.12	4,967.12
3	中芯绍兴三期12英寸特色工艺晶圆制造中试线项目	221,000.00	221,000.00	1,216.02	1,216.02
合计		387,000.00	387,000.00	6,183.14	6,183.14

注:1、截至2023年12月31日的募集资金银行存款利息及理财收益净额,实际金额以资金转出当日专户余额为准。
2、二期晶圆制造项目原拟投入募集资金66.60亿元,其中以自有资金预先投入募投项目后进行置换的金额为16.60亿元,调整募集资金至中芯绍兴三期12英寸特色工艺晶圆制造中试线项目的金额为22.10亿元,调整募集资金至三期12英寸集成电路数模混合芯片制造项目的金额为27.90亿元。
除因募投项目结项产生的节余资金外,募集资金账户尚存有270.85万元原拟用于支付发行费用的募集资金,其中1.20万元拟用于支付发行上市手续费用及其他费用,现已通过公司自有资金支付;另外269.65万元拟用于支付印花税,因印花税为一年一征,且必须使用公司纳税专户进行结算,无法使用募集资金账户结算,公司将以自有资金支付此笔费用。因此公司拟将上述270.85万元永久补充流动资金。
综上,公司本次将节余募集资金合计人民币6,453.99万元永久补充流动资金。
(二)注销募集资金专户情况
因募投项目"MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地技术改造项目"、"二期晶圆制造项目"以及"中芯绍兴三期12英寸特色工艺晶圆制造中试线项目"结项,公司决定将节余募集资金合计人民币6,453.99万元永久补充流动资金,最终具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。同时公司拟将原用于"二期晶圆制造项目"的募集资金27.90亿元调整至"三期12英寸集成电路数模混合芯片制造项目",经公司股东大会审议通过后,公司将与芯联先锋及其开户银行和本次发行的主承销商签订相应的四方募集资金监管协议,并将募集资金27.90亿元划转至相应募集资金专户。
为方便账户管理,上述资金划转完成后,公司拟对相应的募集资金专户进行注销,募集资金专户注销后,公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金专户存储三方监管协议相应终止。
截至2023年12月31日,公司拟注销募集资金专户的具体存放情况如下:
单位:元

序号	开户人	开户银行	募集资金账号	金额
1	芯联集成	招商银行股份有限公司绍兴分行	575903998610666	1,140,319,173.98
2	芯联集成	交通银行股份有限公司绍兴分行	336006190013000309403	1,500,081,892.24
3	芯联集成	浙商银行股份有限公司绍兴分行	3371020110120100158340	4,734,676.57
4	芯联集成	兴业银行股份有限公司绍兴柯桥支行	359060100100165889	206,395,465.05
	芯联先锋	浙商银行股份有限公司绍兴分行	3371020110120100159778	12,160,184.94
合计				2,863,691,392.78

注:截至2023年12月31日,募集资金专户总计余额与本次节余募集资金的差额包含拟划转至募投项目"三期12英寸集成电路数模混合芯片制造项目"27.90亿元以及拟补充流动资金但尚未使用的915.15万元。
四、本次结项募投项目募集资金节余的主要原因
在募集资金投资项目的实施过程中,公司为提高募集资金的使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,使用部分闲置募集资金进行现金管理,同时募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入,形成了上述资金节余。
五、节余募集资金使用计划及对公司的影响
鉴于公司本次结项募投项目已实施完毕且已达到预定可使用状态,公司结合实际经营情况,为提高募集资金使用效率,拟将上述募投项目结项后的节余募集资金6,453.99万元(为募集资金理财收益、银行存款利息的净额等,实际金额以资金转出当日专户余额为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营活动。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金,有利于最大程度发挥募集资金使用效益,符合公司实际经营发展需要,符合全体股东利益,未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用,公司将办理销户手续。专户注销后,公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金专户存储监管协议随之终止。
六、专项意见
(一)独立董事意见
公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,投入公司日常生产经营,履行了相应的审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司相关募集资金管理制度的规定,是公司根据相关募投项目实际建设情况及资金使用情况作出的审慎决定,有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途和其他损害股东利益的情形。
综上,独立董事一致同意公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
(二)监事会意见
监事会认为:公司本次募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金,是基于募投项目实施的实际情况,符合公司发展规划,能够充分发挥募集资金的使用效率,不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。上述事项履行了必要的审议程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及公司相关募集资金管理制度的规定。
综上,监事会同意公司本次募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金事项。
(三)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的审议程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规章制度的要求。本次公司使用节余募集资金永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,符合公司全体股东利益,不存在损害公司及股东,尤其是中小股东利益的情况。
综上,保荐机构对公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。
七、上网公告附件
1、《芯联集成电路制造股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》
2、《海通证券股份有限公司关于芯联集成电路制造股份有限公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》
特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会
2024年1月10日

证券代码:688469 证券简称:芯联集成 公告编号:2024-006

芯联集成电路制造股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2024年1月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2024年1月26日 14点00分
召开地点:浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号芯联集成电路制造股份有限公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2024年1月26日
至2024年1月26日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已于2024年1月9日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年1月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案:不适用
应回避表决的关联股东名称:不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688469	芯联集成	2024/1/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间、地点
登记时间:2024年1月24日(上午9:30-11:00,下午14:00-17:00)
登记地点:浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号芯联集成电路制造股份有限公司
(二)登记手续:拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:
1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续;企业股东委托代理人出席股东大会会议的,凭代理人的身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书(授权委托书格式详见附件1,加盖公章)、企业营业执照/注册证书复印件(加盖公章)、证券账户卡办理登记手续。
2、自然人股东亲自出席股东大会会议的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书(授权委托书格式详见附件1)、委托人的证券账户卡办理登记。
3、上述登记材料均需提供复印件一份。
(三)注意事项
股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
1、会期半天,出席会议的股东食宿及交通费用自理;
2、联系人:张毅、赵若昕
联系电话:0575-88421800 传真:0575-88420899
邮政编码:312000 邮箱:IR@unt-c.com
联系地址:浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号
特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司
董事会
2024年1月10日

附件1:授权委托书
附件1:授权委托书
授权委托书
芯联集成电路制造股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年1月26日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于新增募投项目、调整部分募集资金向新增募投项目的实施主体增资的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。